

# 2024-2030年中国集成电路封装市场深度调查与投资战略咨询报告

报告大纲

共研网

[www.gonyn.com](http://www.gonyn.com)

## 一、报告简介

官网地址：<https://www.gonyn.com/report/1658025.html>

报告价格：电子版: 9600元 纸介版：9600元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-69365838 / 400-700-9228

电子邮箱: kefu@gonyn.com

联系人: 李经理

## 二、报告目录及图表目录

共研网发布的《2024-2030年中国集成电路封装市场深度调查与投资战略咨询报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第1章：中国集成电路封装行业“专精特新”发展概述

1.1 集成电路封装行业的界定

1.1.1 集成电路封装的界定

1.1.2 集成电路封装所处产业链环节

1.1.3 集成电路封装行业分类

1.1.4 集成电路封装所属国民经济行业分类

1.2 “专精特新”概念界定

1.2.1 “专精特新”概念解读

1.2.2 “专精特新”相关概念辨析

(1) 专精特新“小巨人”

(2) 专精特新中小企业

(3) 其他相关概念辨析

1.3 “专精特新”发展背景及发展地位分析

1.3.1 “专精特新”发展背景-内因分析

(1) 中国中小企业发展现状

(2) 中国制造业发展现状

(3) 服务“国内国际双循环”发展格局

1.3.2 “专精特新”发展背景-外因分析

(1) 全球贸易摩擦加剧、外部环境动荡

(2) 中国高科技发展遭遇“卡脖子”

1.3.3 “专精特新”发展地位分析

1.4 本报告研究范围界定说明

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

第2章：全球及中国集成电路封装行业发展现状分析

2.1 全球集成电路封装行业发展现状

- 2.1.1 全球集成电路封装行业发展规模
- 2.1.2 全球集成电路封装行业区域发展格局
- 2.1.3 全球集成电路封装行业企业竞争格局
- 2.2 中国集成电路封装行业发展现状
  - 2.2.1 中国集成电路封装行业发展规模
  - 2.2.2 中国集成电路封装行业区域发展格局
  - 2.2.3 中国集成电路封装行业企业竞争格局
- 2.3 中国集成电路封装行业技术水平及国产化现状
  - 2.3.1 中国集成电路封装行业技术发展现状
    - (1) 集成电路封装行业技术创新现状
    - (2) 集成电路封装行业专利申请情况
    - (3) 集成电路封装行业技术研发趋势
  - 2.3.2 中国集成电路封装行业国产化发展现状
    - (1) 集成电路封装行业国产化率分析
    - (2) 集成电路封装行业本土企业布局
- 2.4 中国集成电路封装行业发展机遇与挑战分析

### 第3章：中国集成电路封装行业“专精特新”政策环境及投融资环境分析

- 3.1 中国集成电路封装行业“专精特新”政策环境分析
  - 3.1.1 国家层面集成电路封装行业发展相关政策及规划汇总解读
    - (1) 集成电路封装行业发展相关政策汇总
    - (2) 集成电路封装行业发展相关规划汇总
  - 3.1.2 国家层面集成电路封装行业“专精特新”相关政策汇总解读
  - 3.1.3 国家“十四五”规划对集成电路封装行业发展的影响分析
  - 3.1.4 “国内国际双循环”战略的提出对集成电路封装行业的影响分析
  - 3.1.5 集成电路封装行业“专精特新”发展的政策机遇分析
- 3.2 中国集成电路封装行业“专精特新”投融资环境分析
  - 3.2.1 中国集成电路封装行业“专精特新”领域主要资金来源
  - 3.2.2 中国集成电路封装行业“专精特新”领域投融资主体
  - 3.2.3 中国集成电路封装行业“专精特新”领域投融资方式
  - 3.2.4 中国集成电路封装行业“专精特新”领域投融资事件汇总
  - 3.2.5 中国集成电路封装行业“专精特新”领域投融资机遇分析
    - (1) 集成电路封装行业“专精特新”财税扶持力度
    - (2) 集成电路封装行业“专精特新”信贷支持政策
    - (3) 集成电路封装行业“专精特新”市场化融资渠道

#### (4) 北京交易所成立带来的发展机遇分析

### 3.3 中国集成电路封装行业“专精特新”发展战略支撑及保障

## 第4章：中国集成电路封装行业“专精特新”企业培育方案及培育现状解读

### 4.1 中国集成电路封装行业“专精特新”企业培育方案解读

#### 4.1.1 集成电路封装行业国家级“专精特新”企业培育目的

#### 4.1.2 集成电路封装行业国家级“专精特新”企业培育对象

#### 4.1.3 集成电路封装行业国家级“专精特新”企业培育内容

#### 4.1.4 集成电路封装行业国家级“专精特新”企业培育措施

#### 4.1.5 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业奖励标准

### 4.2 中国集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报条件及流程解读

#### 4.2.1 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报-基本条件

#### 4.2.2 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报-专项条件

#### 4.2.3 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报-分类条件

#### 4.2.4 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报流程解读

### 4.3 中国集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业培育现状分析

#### 4.3.1 全国专精特新“小巨人”企业培育现状

##### (1) 专精特新“小巨人”企业培育进展

##### (2) 专精特新“小巨人”企业培育特征

##### (3) 专精特新“小巨人”企业行业分布

#### 4.3.2 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业培育现状

##### (1) 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业培育进展

##### (2) 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业培育特征

## 第5章：中国集成电路封装产业链全景梳理及“专精特新”鼓励布局方向

### 5.1 中国集成电路封装产业结构属性（产业链）分析

#### 5.1.1 中国集成电路封装产业链结构梳理

#### 5.1.2 中国集成电路封装产业链生态图谱

### 5.2 中国集成电路封装产业价值属性（价值链）分析

#### 5.2.1 中国集成电路封装行业成本结构分析

#### 5.2.2 中国集成电路封装行业价值链分析

### 5.3 中国集成电路封装行业发展痛点分析

### 5.4 中国集成电路封装产业链“专精特新”鼓励布局方向

## 第6章：中国集成电路封装产业链环节“专精特新”布局状况研究

## 6.1 中国集成电路封装行业之先进封装材料“专精特新”布局状况研究

### 6.1.1 中国集成电路封装行业之先进封装材料发展现状分析

- (1) 先进封装材料市场发展规模
- (2) 先进封装材料技术发展现状
- (3) 先进封装材料国产化发展现状

### 6.1.2 中国集成电路封装行业之先进封装材料发展痛点分析

### 6.1.3 中国集成电路封装行业之先进封装材料“专精特新”市场培育现状

### 6.1.4 中国集成电路封装行业之先进封装材料市场竞争格局分析

### 6.1.5 中国集成电路封装行业之先进封装材料发展前景及趋势分析

## 6.2 中国集成电路封装行业之封测设备“专精特新”布局状况研究

### 6.2.1 中国集成电路封装行业之封测设备发展现状分析

- (1) 封测设备市场发展规模
- (2) 封测设备技术发展现状
- (3) 封测设备国产化发展现状

### 6.2.2 中国集成电路封装行业之封测设备发展痛点分析

### 6.2.3 中国集成电路封装行业之封测设备“专精特新”市场培育现状

### 6.2.4 中国集成电路封装行业之封测设备市场竞争格局分析

### 6.2.5 中国集成电路封装行业之封测设备发展前景及趋势分析

## 6.3 中国集成电路封装行业之SIP封装“专精特新”布局状况研究

### 6.3.1 中国集成电路封装行业之SIP封装发展现状分析

- (1) SIP封装市场发展规模
- (2) SIP封装技术发展现状
- (3) SIP封装国产化发展现状

### 6.3.2 中国集成电路封装行业之SIP封装发展痛点分析

### 6.3.3 中国集成电路封装行业之SIP封装“专精特新”市场培育现状

### 6.3.4 中国集成电路封装行业之SIP封装市场竞争格局分析

### 6.3.5 中国集成电路封装行业之SIP封装发展前景及趋势分析

## 6.4 中国集成电路封装行业之WLCSP封装“专精特新”布局状况研究

### 6.4.1 中国集成电路封装行业之WLCSP封装发展现状分析

- (1) WLCSP封装市场发展规模
- (2) WLCSP封装技术发展现状
- (3) WLCSP封装国产化发展现状

### 6.4.2 中国集成电路封装行业之WLCSP封装发展痛点分析

### 6.4.3 中国集成电路封装行业之WLCSP封装“专精特新”市场培育现状

### 6.4.4 中国集成电路封装行业之WLCSP封装市场竞争格局分析

#### 6.4.5 中国集成电路封装行业之WLCSP封装发展前景及趋势分析

### 第7章：中国集成电路封装行业区域发展格局及“专精特新”发展研究

#### 7.1 中国集成电路封装产业资源区域分布状况

#### 7.2 中国集成电路封装行业企业数量区域分布

#### 7.3 中国集成电路封装行业区域发展格局分析

#### 7.4 中国各省市集成电路封装行业“专精特新”政策环境分析

#### 7.5 中国各省市集成电路封装行业“专精特新”企业培育方案及申报条件

##### 7.5.1 集成电路封装行业省市级“专精特新”企业培育方案解读

###### (1) 省级“专精特新”企业培育方案解读

###### (2) 市级“专精特新”企业培育方案解读

##### 7.5.2 集成电路封装行业省市级“专精特新”企业奖励标准

##### 7.5.3 集成电路封装行业省市级“专精特新”企业申报条件解读

###### (1) 省级“专精特新”企业申报条件

###### (2) 市级“专精特新”企业申报条件

##### 7.5.4 集成电路封装行业省市级“专精特新”企业申报流程解读

###### (1) 省级“专精特新”企业申报流程

###### (2) 市级“专精特新”企业申报流程

#### 7.6 中国各省市集成电路封装行业“专精特新”市场培育现状

##### 7.6.1 各省市集成电路封装行业“专精特新”企业培育规模

##### 7.6.2 各省市集成电路封装行业“专精特新”市场培育格局

##### 7.6.3 各省市集成电路封装行业“专精特新”市场培育特征

### 第8章：中国集成电路封装行业代表性“小巨人”企业布局对比及案例研究

#### 8.1 中国集成电路封装行业代表性“小巨人”企业布局对比

#### 8.2 中国集成电路封装行业代表性“小巨人”企业布局案例研究

##### 8.2.1 企业一

###### (1) 企业发展历程及基本信息

###### (2) 企业发展状况

###### (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍

###### (4) 企业集成电路封装产业链布局状况

###### (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向

###### (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

##### 8.2.2 企业二

###### (1) 企业发展历程及基本信息

- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

#### 8.2.3 企业三

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

#### 8.2.4 企业四

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

#### 8.2.5 企业五

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

#### 8.2.6 企业六

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

#### 8.2.7 企业七

- (1) 企业发展历程及基本信息



- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

#### 8.2.8 企业八

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

#### 8.2.9 企业九

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

#### 8.2.10 企业十

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

### 第9章：中国集成电路封装行业“专精特新”发展趋势预判及前景预测

#### 9.1 中国集成电路封装行业市场前景预测

#### 9.2 中国集成电路封装行业“专精特新”发展趋势预判

#### 9.3 中国集成电路封装行业“专精特新”发展前景预测

### 第10章：中国集成电路封装行业“专精特新”投资特性及投资机会分析

#### 10.1 中国集成电路封装行业“专精特新”投资特性分析

##### 10.1.1 中国集成电路封装行业“专精特新”投资壁垒分析

10.1.2 中国集成电路封装行业“专精特新”投资风险预警及防范

10.2 中国集成电路封装行业“专精特新”投资价值评估

10.3 中国集成电路封装行业“专精特新”投资机会分析

10.3.1 产业链薄弱环节投资机会

10.3.2 区域市场投资机会

10.3.3 细分市场投资机会

10.4 中国集成电路封装行业“专精特新”潜在发展方向分析

第11章：中国集成电路封装行业“专精特新”投资策略及发展建议

11.1 中国集成电路封装行业“专精特新”投资策略

11.2 中国集成电路封装行业“专精特新”发展建议

图表目录

图表1：中国集成电路封装行业本土企业布局情况

图表2：中国集成电路封装行业发展机遇与挑战分析

图表3：截至2021年中国集成电路封装行业发展政策汇总-国家层面

图表4：截至2021年中国集成电路封装行业发展规划汇总-国家层面

图表5：截至2021年中国集成电路封装行业“专精特新”发展政策解读-国家层面

图表6：中国集成电路封装行业发展痛点分析

图表7：中国集成电路封装行业先进封装材料本土企业布局情况

图表8：中国集成电路封装行业先进封装材料市场发展痛点分析

图表9：中国集成电路封装行业之封测设备本土企业布局情况

图表10：中国集成电路封装行业之封测设备发展痛点分析

图表11：中国集成电路封装行业之SIP封装本土企业布局情况

图表12：中国集成电路封装行业之SIP封装发展痛点分析

图表13：中国集成电路封装行业之WLCSP封装本土企业布局情况

图表14：中国集成电路封装行业之WLCSP封装发展痛点分析

图表15：企业一发展历程

图表16：企业一基本信息表

图表17：企业一股权穿透图

图表18：企业一经营状况

图表19：企业一整体业务架构

图表20：企业一销售网络布局

图表21：企业一集成电路封装业务布局优劣势分析

图表22：企业二发展历程

图表23：企业二基本信息表

图表24：企业二股权穿透图

图表25：企业二经营状况

图表26：企业二整体业务架构

图表27：企业二销售网络布局

图表28：企业二集成电路封装业务布局优劣势分析

图表29：企业三发展历程

图表30：企业三基本信息表

详细请访问：<https://www.gonyn.com/report/1658025.html>